УДК537.311.322

ISSN 1729-4428

## Л.П. Ромака<sup>1</sup>, В.В.Ромака<sup>2</sup>, В.Я. Крайовський<sup>2</sup>,Ю.В. Стадник<sup>1</sup>, П.-Ф. Рогль<sup>3</sup>, А.М. Горинь<sup>1</sup>

### Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур напівпровідникового твердого розчину Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn

<sup>1</sup>Львівський національний університет ім. І.Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, Львів, 79005, Україна, e-mail: <u>romakal@franko.lviv.ua;</u>

<sup>2</sup>Національний університет "Львівська політехніка", вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна; <sup>3</sup>Віденський університет, вул. Верингерштрасе, 42, Відень, А-1090, Австрія

Досліджено особливості структурних, енергетичних, термодинамічних та кінетичних характеристик твердого розчину  $Hf_{1,x}Tm_xNiSn$  у діапазоні: T = 80 - 400 К, x = 0 - 0,40. Підтверджено невпорядкованість кристалічної структури сполуки HfNiSn як результат зайняття атомами Ni  $(3d^84s^2)$  до ~1% кристалографічної позиції 4a атомів Hf  $(5d^26s^2)$ , що генерує у кристалі структурні дефекти донорної природи. Показано, що уведення атомів Tm упорядковує кристалічну структуру («заліковує» структурні дефекти). Виявлено механізми одночасного генерування структурних дефектів як акцепторної природи при заміщенні атомів Hf $(5d^26s^2)$  атомами Tm  $(4f^{43}5d^06s^2)$ , так і донорної як результат появи вакансій у позиції атомів Sn (4b), які визначають механізми електропровідності Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn.

Ключові слова: кристалічна і електронна структури, електропровідність, коефіцієнт термо-ерс.

Стаття поступила до редакції; прийнята до друку 15.03.2016.

### Вступ

Запропонована робота продовжує програму досліджень термочутливих матеріалів на основі сполуки HfNiSn (стр. тип MgAgAs, пр. група  $F\overline{4}3m$  [1]) при різних способах уведення та типу домішок [2]. Важливість таких досліджень обумовлена тим, що матеріали на базі інтерметалічних напівпровідників *n*-ZrNiSn, *n*-TiNiSn та *n*-HfNiSn володіють високою ефективністю перетворення теплової енергії в електричну [3-5].

Структурні дослідження сполуки HfNiSn [6] виявили невпорядкованість її кристалічної структури як результат зайняття атомами Ni  $(3d^84s^2)$  до ~1 % кристалографічної позиції 4*a* атомів Hf  $(5d^26s^2)$ , а формула сполуки набирала виду (Hf<sub>1-y</sub>Ni<sub>y</sub>)NiSn,  $y \le$ 0,01. Часткове заміщення атомів Hf на Ni генерує у кристалі структурні дефекти донорної природи («апріорне» легування донорами [2]), оскільки Ni  $(3d^84s^2)$  володіє більшим за Hf  $(5d^26s^2)$  числом *d*електронів. Як наслідок, електрони є основними носіями електрики.

У свою чергу, уведення у структуру HfNiSn атомів рідкісноземельних металів (R) Lu  $(4f^{15}5d^{1}6s^{2})$ [7] чи Y  $(4d^{1}5s^{2})$  [8] шляхом заміщення атомів Hf генерує у  $Hf_{1-x}R_xNiSn$  структурні дефекти акцепторної природи, оскільки атоми Lu та Y мають на один 5*d*-електрон менше, ніж Hf. При цьому відбувається упорядкування кристалічної структури – атоми меншого розміру Ni покидають позицію 4*a* атомів Hf, а також має місце перекомпенсація напівпровідника  $Hf_{1-x}R_xNiSn$  і дірки стають основними носіями електрики.

3 іншого боку, наявність У матриці напівпровідника значного числа додатно та від'ємно заряджених центрів робить його сильнолегованим та компенсованим, також а £ причиною флуктуацій зон неперервних великомасшабних енергій [9]. Нижче досліджені механізми генерування заряджених центрів різної природи (структурних дефектів) у напівпровідниковому твердому розчині Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, які викликають модуляцію зон неперервих енергій, а також встановлено їхній вплив на структурні, енергетичні та кінетичні характеристики термочутливого матеріалу.

#### I. Методики дослідження

Зразки синтезовано у лабораторії Інституту фізичної хімії Віденського університету шляхом сплавляння шихти компонентів в електродуговій печі в інертній атмосфері. Методом рентгеноструктурного аналізу (метод порошку) отримано значення періодів кристалічної гратки  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ , x = 0 - 0, 10, а за допомогою програми Fullprof [10] встановлено її параметри: координати атомів, теплові параметри, зайнятість кристалографічних позицій. Використано масиви даних рентгенівських відбить (дифрактометр Guinier-Huber image plate system, СиКа<sub>1</sub>). Для точності підвищення структурних досліджень розрахунок проведено з урахуванням дифракції рентгенівського випромінювання α- та β-серій. Хімічний та фазовий склад зразків контролювався з використанням скануючого електронного мікроскопа за допомогою мікрозондового аналіза на основі рентгенівської спектроскопії (Carl Zeiss DSM 962 та Zeiss Supra 55VP, пакет програм INCA (Oxford Instruments)). Стандартні відхилення не перевищували 1 ат.%. Розрахунки електронної структури проводились методами Корінги-Кона-Ростокера (KKR) у наближенні когерентного потенціалу (СРА) і локальної густини (LDA) [11]. Для розрахунків використано експериментальні значення постійної кристалічної гратки у k-решітці розмірами 10×10×10 та тип параметризації обміннокореляційного потенціалу Moruzzi-Janak-Williams [12]. Ширина енергетичного вікна при розрахунку DOS, що охоплена контуром, складає 16 eB, а точність розрахунку положення рівня Фермі є<sub>F</sub> становить ±8 меВ для 1000 значень енергії. Вимірювалися температурні залежності питомого електроопору ( $\rho$ ) та коефіцієнта термо-ерс ( $\alpha$ ) відносно міді зразків Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn у діапазоні температур T = 80 - 400 К та концентрацій x = 0 -0,10.

# II. Дослідження особливостей кристалічної структури Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn

Рентгенівські фазовий та структурний аналізи показали, що дифрактограми зразків Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn,

x = 0 - 0,50, індексуються у структурному типі MgAgAs [11]. Так, на дифрактограмах зразків Нf<sub>1-</sub> <sub>x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, x = 0 - 0,10, не виявлено слідів інших фаз. У зразках складів 0,01< х ≤0,40 на дифрактограмах виявлено відбиття незначної інтенсивності, які належать фазі TmNiSn (стр. тип TiNiSi), а у зразках з 0.40<х виявлено відбиття від кількох фаз – TmNiSn та  $Tm_{11}Sn_{10}$  (стр. тип  $Ho_{11}Ge_{10}$ ). У свою чергу, мікрозондовий аналіз концентрації атомів на поверхні зразків  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ , x = 0 - 0,10, показав їхню відповідність вихідним складам шихти, що є одним з доказів прогнозованого заміщення атомів Hf на Tm, а у зразках складів 0.01 < x ≤ 0.50 були виявлені сліди вищезгаданих інших фаз. Як електрокінетичні результат, характеристики досліджувалися лише для однофазних зразківНf<sub>1</sub>.  $_{x}$ Tm $_{x}$ NiSn, x = 0 - 0, 10.

Заміщення атомів меншого розміру Hf ( $r_{\rm Hf}$  = 0,158 нм) більшими атомами Tm ( $r_{\rm Tm}$  = 0,175 нм) очікувано приводить до збільшення значень періоду елементарної комірки a(x) Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn (рис. 1*a*, крива 2), а відхилення значень a(x) від лінійної залежності при x > 0,40 фіксує межу існування твердого розчину. Експериментальний результат обмеженої розчинності атомів Tm узгоджується з результатами термодинамічних розрахунків, зокрема, зміни значень вільної енергії  $\Delta G$  Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn (рис. 1*b*). З рис. 1*b* видно, що за умови гомогенізуючого відпалу зразків за температури 1073 К розчинність атомів Tm обмежена концентрацією  $x \le 0,40$  (мінімум на залежності  $\Delta G(x)$ ).

Уточнення кристалічної структури Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn методом порошку з одночасним уточненням ізотропних параметрів атомного заміщення та зайнятості кристалографічної позиції Hf (4*a*) підтвердило результат [6] стосовно невпорядкованості структури HfNiSn. З іншого боку, уточнення структури також показало, що найменше значення коефіцієнта невідповідності моделі кристалічної структури та масиву брегівських відбить ( $R_{\rm Br} \approx 2.6$  %) отримано для моделі, в якій зайнятість позиції атомів Hf(Tm) для  $x \ge 0.01$ становить 100 %. Іншими словами, уведення атомів



**Fig. 1.** Change the values of the period the unit cell a(x): 1 - calculation; 2 - experiment (a) and free energy  $\Delta G$  (b) at different temperatures: 1 - 0 K, 2 - 673 K, 3 - 1073 K (b) of Hf<sub>1-X</sub>Tm<sub>X</sub>NiSn.



Fig. 2. The calculation of the density of electron states DOS for the ordered structure Hf<sub>1-X</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn.

Тт у структуру сполуки HfNiSn, як і у попередніх випадках Hf<sub>1-x</sub>R<sub>x</sub>NiSn [7, 8], упорядковує кристалічну структуру («заліковує» структурні дефекти) і атоми Nіпокидають позицію 4*a* атомів Hf. Упорядкування структури Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn робить її термічно стійкою до температури гомогенізуючого відпалу 1073 K, створюючи передумови для отримання матеріалу зі стабільними характеристиками.

Звертаємо увагу на наявність двох лінійних ділянок на залежності a(x) Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn:  $0 \le x \le 0.02$ та  $x \ge 0,04$  (рис. 1*a*, вставка). Така, на перший погляд, незначна особливість у поведінці a(x) є характерною для усіх раніше досліджених споріднених твердих розчинів  $Hf_{1-x}R_xNiSn$  [7, 8] та  $Zr_{1-x}R_xNiSn$  [13] і слугувала додатковим підтвердженням правильності запропонованої моделі кристалічної структури п-HfNiSn [6]. Дійсно, якщо у вихідній структурі сполуки HfNiSn позиція атомів Hf частково зайнята атомами меншого розміру Ni (r<sub>Ni</sub> = 0 124 нм), то уведення у структуру атомів рідкісноземельного металу значно більшого розміру Тт (на ~40%) приводить до витіснення атомів Ni на ділянці концентрацій  $0 \le x \le 0.02$ . При концентраціях домішки  $x \ge 0.02$  всі атоми Ni будуть витіснені з позиції атомів Hf і має місце лише заміщення атомів Нf нa Tm, у яких різниця в атомних радіусах є значно меншою. У такому разі, амплітуда зміни значень періоду елементарної комірки Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn на

ділянках  $0 \le x \le 0,02$  та  $x \ge 0,04$  буде різною; у першому випадку ця зміна буде більшою, на що вказує більший кут нахилу залежності a(x), що є можливим лише при витісненні з позиції 4*a* атомів меншого розміру Ni атомами значно більшого розміру Tm.

Виходячи з припущення, що структура HfNiSn упорядкована, а домішкові атоми Tm витісняють з позиції 4*a* атоми Hf, розраховано зміну значень періоду елементарної комірки a(x) Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn (рис. 1*a*, крива 1). Співставлення розрахованих та експериментальних значень a(x) Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn демонструє відсутність структурних особливостей, пов'язаних з витісненням атомів Ni з позиції атомів Hf, оскільки вони при розрахунках не враховувалися.

Процес упорядкування кристалічної структури  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ , окрім структурних особливостей, повинен привести також до суттєвого перерозподілу густини електронних станів. Так, якщо в HfNiSn існують структурні дефекти донорної природи як результат витіснення до ~ 1% атомів Hf атомами Ni [6], то упорядкування кристалічної структури Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn приводить до зменшення числа донорів, оскільки атоми Ni покидають позицію атомів Hf (4*a*) («заліковування» структурних дефектів донорної природи). З іншого боку, оскільки атом Tm  $(4f^{13}5d^{0}6s^{2})$  володіє на два 5*d*-електрони менше, ніж атом Hf, то процес заміщення атомів Hf на Tm

генерує у кристалі структурні дефекти акцепторної природи.

Таким чином, уведення у структуру сполуки HfNiSn атомів рідкісноземельного металу Тт заміщення атомів (x = 0 - 0.10)шляхом Hf упорядкувує структуру та одночасно зменшує число дефектів донорної природи (Ni у позиції 4a) та збільшує число структурних дефектів акцепторної природи (Tm у позиції 4a). що змінить співвідношення числа дефектів донорної та акцепторної природи (ступінь компенсації) твердого розчину Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn.

## Ш. Дослідження електронної структури Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn

Для прогнозування поведінки рівня Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$ , ширини забороненої зони  $\varepsilon_{\rm g}$  та кінетичних характеристик твердого розчину  ${\rm Hf}_{1-x}{\rm Tm}_x{\rm NiSn}, 0 \le x \le$ 0,10, розраховано густину електронних станів (DOS) (рис. 2). Беручи до уваги результати структурних досліджень, згідно яких уведення у сполуку HfNiSn атомів Tm упорядковує її кристалічну структуру, розрахунок DOS проведено для упорядкованого варіанту структури.

*n*-HfNiSn найменших При уведенні В концентрацій акцепторної домішки Тт збільшиться ступінь компенсації [9], а рівень Фермі є<sub>F</sub> почне рухатися від зони провідності є<sub>с</sub>, на відстані ~ 81,3 меВ від якої він розташовувався [6], до середини забороненої зони є<sub>д</sub> (рис. 2). При концентраціях Тт, коли рівень Фермі є<sub>F</sub> перетне середину забороненої зони ( $x \approx 0,02$ ) і рухається до валентної зони  $\varepsilon_V$ , яку перетне при  $x \approx 0,04$ , зміниться тип провідності напівпровідника, а основними носіями струму стануть дірки. Подальше легування напівпровідника p-Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn,  $x \approx 0.04$ , акцепторами зменшуватиме ступінь компенсації. Окрім дрейфу рівня Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$ , викликаного зміною співвідношення чиспа акцепторів та донорів, зменшується також ширина забороненої зони  $\varepsilon_g Hf_{1-x} Tm_x NiSn$  від значень  $\varepsilon_g(x=0)$  $\approx 514$  меВ до значень  $\varepsilon_g(x = 0.10) \approx 430$  меВ.

Таким чином, результати розрахунку густини електронних станів  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ , виконані на основі структурних досліджень, дають лише акцепторну природу генерованих у кристалі структурних дефектів. Результати досліджень кінетичних характеристик  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$  покажуть ступінь адекватності таких розрахунків реальним процесам у напівпровідниковому твердому розчині.

### IV. Дослідження електрокінетичних характеристик Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn

Температурні залежності питомого опору  $\ln\rho(1/T)$  та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(1/T)$  для  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn, x = 0 - 0,10$ , (рис. 3, 4) є типовими для сильнолегованих та компенсованих напівпровідників з високо- та низькотемпературними активаційними ділянками, вказуючи на кілька механізмів провідності [2, 9]. Із

високотемпературних ділянок залежностей  $\ln\rho(1/T)$ та  $\alpha(1/T)$  обчислено значення енергії активації з  $\varepsilon_F$  у зони неперервних енергій  $\varepsilon_1^{\rho}$  та енергії активації  $\varepsilon_1^{a}$ , яка є амплітудою модуляції зон неперервних енергій, відповідно. У свою чергу, з низькотемпературних ділянок залежностей  $\ln\rho(1/T)$  та  $\alpha(1/T)$  – значення енергії активації стрибкової провідності  $\varepsilon_3^{\rho}$  по станах з енергіями, близькими до рівня Фермі  $\varepsilon_F$ , та, відповідно, значення амплітуди модуляції дрібномасштабної флуктуації  $\varepsilon_3^{a}$  [2, 9].

Наявність на залежностях  $\ln\rho(1/T)$  для  $Hf_{1-}$ <sub>x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn. високотемпературних  $x \ge 0.04$ , активаційних ділянок вказує на розташування рівня Фермі є<sub>F</sub> у забороненій зоні. Отриманий результат суперечить результатам розрахунків DOS (рис. 2), які прогнозували перетин рівнем Фермі є<sub>F</sub> валентної зони і переходом провідності діелектрик-метал [9] при  $x \approx 0.04$ . Для Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, x = 0.10 активаційна ділянка на  $\ln\rho(1/T)$  присутня лише за низьких температур, вказуючи на стрибковий механізм електропровідності  $\varepsilon_3^{\rho}$  по станах з енергіями, близькими до рівня Фермі є<sub>F</sub>. Тобто, за низьких температур рівень Фермі  $\varepsilon_F$  у Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, x = 0,10, знаходиться за межами валентної зони.

Від'ємні значення коефіцієнта термо-ерс п-HfNiSn (рис. 46 та 5) є зрозумілими і пов'язані з «апріорним легуванням» [2] базового напівпровідника n-HfNiSn донорами (позиція атомів Нf до ~ 1 % зайнята атомами Ni) [6]. У свою чергу, у зразку  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ , x = 0.01, концентрація акцепторної домішки Ттвідповідає концентрації присутніх донорів у *n*-HfNiSn [6] і реалізується стан, близький до повної компенсації, коли рівень Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$ мав би розташуватися біля середини є<sub>g</sub>. Так, додатні коефіцієнта термо-ерс за низьких значення температур (рис. 4б та 5) вказують, що концентрація генерованих акцепторів переважає число структурних дефектів донорної природи, зумовлених неупорядкованістю структури HfNiSn, а тому рівень Фермі є фіксується домішковою акцепторною зоною (біля валентної зони). Однак, за T = 380 К знак коефіцієнта термо-ерс  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ , x = 0,01, (рис. 46, 5) стає від'ємним:  $\alpha(x = 0,01) = -3.13 \text{ мкBK}^{-1}$ . Очевидно з температурою змінюється число іонізованих донорів та акцепторів. Екстремум на залежності  $\alpha(1/T)$  для зразка Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, x = 0,01, за  $T \approx 270$  К відображає перетин рівнем Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$ середини забороненої зони і дрейфом назад до зони провідності. Виходить, що у  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ , x = 0,01, концентрація донорів переважає концентрацію акцепторів, а вони мали бути однаковими. Можна припустити, що у кристалі генеруються також донори за невідомим досі механізмом.

Те, що атоми Tm, уведені у сполуку HfNiSn, приводять до генерування структурних дефектів акцепторної природи показують залежності зміни значень питомого електроопору в усьому температурному та концентраційному діапазонах (рис. 5). З характеру зміни значень питомого електроопору  $\rho(x)$  Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, x = 0 - 0,01, за різних температур видно описану вище динаміку зміни кристалічної структури напівпровідника, у процесі якої одночасно зменшується число вільних



Fig. 3. Temperature dependence of electrical resistivity  $ln\rho (1 / T) Hf_{1-x}Tm_xNiSn:$ a - 1 - x = 0, 2 - x = 0.01, 3 - x = 0,03, 4 - x = 0.07; b - x = 0.10.



Fig. 4. Temperature dependence of thermo-e.m.f.  $\alpha$  (1/T) Hf<sub>1-X</sub>Tm<sub>X</sub>NiSn: a - x = 0; b - 1 - x = 0.10, 2 - x = 0.07, 3 - x = 0.03, 4 - x = 0.01.

електронів за двома механізмами: (1) – зменшення числа донорів, коли атоми Ni покидають позицію 4*a* атомів Hf («заліковування» дефектів донорної природи [6]) та (2) – виморожування вільних електронів в акцепторну зону, генеровану при зайнятті атомами Tm позиції атомів Hf. Так, уведення найменшої концентрації Tm (x = 0,01) за температури 80 К супроводжується зменшенням значень питомого електроопору від  $\rho(x = 0) = 1029,1$  мкОм·м до  $\rho(x = 0,01) = 902,32$  мкОм·м та  $\rho(x = 0.03) =$ 169,31 мкОм·м.

Якби концентрація уведених акцепторів була меншою, або концентрація вільних електронів була більшою, ми спостерігали би ріст значень  $\rho(x)$  через зменшення числа вільних електронів у напівпровіднику *n*-типу при легуванні акцепторами. Однак, при уведенні найменшої в експерименті концентрації атомів Tm отримуємо напівпровідник діркового типу провідності. У свою чергу, максимум на залежності  $\rho(x)$  Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn,  $x \ge 0.01$ , за температур  $T \ge 160$  K (рис. 5) показує, що рівень Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  дрейфує до середини забороненої зони  $\varepsilon_{\rm g}$ , що супроводжується збільшенням числа вільних електронів за невідомим досі механізмом, що змінює ступінь компенсації напівпровідника.

Для випадків  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ , x = 0,02 - 0,10,додатні значення коефіцієнта термо-ерс за низьких температур вказують, що концентрація генерованих дефектів акцепторної природи є більшою, ніж донорних, а рівень Фермі є<sub>F</sub> фіксується домішковою акцепторною зоною. Доказом того, що є<sub>г</sub> рухається у напрямі валентної зони Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn при збільшенні концентрації атомів Tm, є поведінка залежності коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x)$  (рис. 5). Так, значення коефіцієнта термо-ерс при 80 К змінюються від значень  $\alpha(x=0) = -178.1$  мкВК<sup>-1</sup> до  $\alpha(x=0,01) =$ 0,82 мкВК<sup>-1</sup> та  $\alpha(x = 0,03) = 6,82$  мкВК<sup>-1</sup>, що вказує на зміну типу основних носіїв струму від електронів, x = 0, дірок, при до при  $x \ge 0.01$ . Тепер високотемпературна активаційна ділянка на залежностях  $\ln\rho(1/T)$  Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, x = 0.02 - 0.10(рис. 3) є проявом термічного закиду дірок з рівня Фермі є<sub>F</sub>, що фіксується акцепторною зоною, у валентну зону, збільшуючи число вільних дірок.



Fig. 5. Change the values of electrical resistivity  $\rho(x)$  (1) and coefficient of thermal-e.m.f. a(x) (2) of the  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$  at different temperatures.

Натомість, металічний хід залежності  $\ln\rho(1/T)$  за високих температур та додатні значення коефіцієнта термо-ерс для  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ , x = 0,10, вказують, що рівень Фермі  $\varepsilon_F$  перетнув валентну зону: відбувся перехід провідності діелектрик-метал [9]. Однак, за T < 250 К стрибковий механізм електропровідності вказує на вихід рівня Фермі  $\varepsilon_F$  із валентної зони у заборонену зону, що є можливим лише за умови появи донорів за невідомим механізмом, які компенсують наявні у кристалі акцептори.

Таким чином, аналіз характеру зміни значень температурних та концентраційних залежностей питомого опору та коефіцієнта термо-ерс  $Hf_{1,x}Tm_xNiSn$  вказує на наявність складного механізму генерування структурних дефектів як акцепторної природи при зайнятті атомами Tm позиції 4*a* атомів Hf, так і донорної природи за невідомим механізмом.

Проведемо тепер аналіз зміни значень  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ , енергетичних характеристик отриманих з температурних залежностей питомого опору  $\ln\rho(1/T)$  (рис. 3) та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(1/T)$ (рис. 4). 3 рис. 6а видно, що в Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn при збільшенні концентрації акцепторів зменшуються значення енергії активації  $\varepsilon_1^{\rho}(x)$  від значення 81,3 мeB (для *x* = 0) до нуля (*x* = 0,10). Зазначимо, що значення енергії  $\varepsilon_1^{\rho}(x)$  для напівпровідника *n*-HfNiSn відображає енергетичну щілину між положенням рівня Фермі є та краєм зони провідності, а в Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn для найменшої концентрації Tm і усіх подальших відображає енергетичну щілину між рівнем Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  та валентною зоною.

Нами обчислено швидкості дрейфу рівня Фермі

 $\varepsilon_{\rm F}$  до валентної зони на ділянках концентрацій x = 0 – 0,03 та x = 0,03 - 0,10. Виявилося, що на ділянці x =0-0.03 швидкість дрейфу становить  $\Delta \varepsilon_{\rm F}/\Delta x =$ 22,6 меВ/% Tm, а на ділянці  $x = 0,.03 - 0,10 - \Delta \varepsilon_F / \Delta x =$ 2,3 меВ/%Tm. Виникає запитання, що є причиною суттєвої відмінності швидкості руху рівня Фермі до валентної зони при збільшенні концентрації атомів Tm? Окрім того, у досліджених зразках концентрація акцепторної домішки Tm збільшувалася за лінійним законом, що зумовлює збільшення концентрації структурних дефектів акцепторної природи за таким же законом. У такому разі, чому трафік рівня Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  при його дрейфі до валентної зони не є лінійним? Що «тормозить» такий рух, причому чим більшою є концентрація уведених акцепторів тим швидкість руху рівня Фермі є є меншою? З основ фізики напівпровідників відомо, що це можливе за умови генерування донорів за невідомим механізмом, концентрація яких наростає при збільшенні вмісту Tm

Далі, якщо порівняти швидкість руху рівня Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  до валентної зони, отриману з розрахунків DOS для упорядкованого варіанту структури Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn (рис. 2), коли генеруються лише дефекти акцепторної природи. 3 результатами експериментальних досліджень (рис. 6а), то в експерименті вона менша у ~ 2,5 рази. Оскільки положення рівня Фермі є<sub>F</sub> співвідношення у напівпровіднику відображає донорів та акцепторів (ступінь компенсації), то знову напрошується висновок про наявність у твердому розчині  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$ донорів невідомого походження.

З іншого боку, якщо у кристалі одночасно генеруються з різною швидкістю структурні дефекти донорної та акцепторної природи, що приводить до зміни ступеню компенсації напівпровідника, то це повинно знайти своє відображення у зміні амплітуди модуляції  $\varepsilon_1^{a}(x)$ 30H неперервних енергій сильнолегованого компенсованого та напівпровідника [2, 9]. Причому зміна значень  $\varepsilon_1^{a}(x)$ повинна змінюватися за законом, який відображає співвідношення в напівпровіднику іонізованих акцепторів та донорів. Можемо бачити (рис. 6б), що у випадку n-HfNiSn амплітуда модуляції становить  $\varepsilon_1^{\alpha}(x=0) = 50,9$  меВ. Уведення у напівпровідник електронного типу провідності найменшої концентрації домішки Tm (x = 0,01) приводить до стрімкого збільшенням ступеню компенсації, на що вказує значення амплітуди модуляції  $\varepsilon_1^{a}(x=0,01) =$ 80,5 меВ, а дірки стають основними носіями струму.

Легування тепер папівпровідника *p*-Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, x = 0.01, акцепторною домішкою Tm зменшує ступінь компенсації. тобто число іонізованих акцепторів набагато переважає концентрацію донорів, що знаходить сво€ відображення V модуляції зменшенні значень амплітуди до  $\varepsilon_1^{\alpha}(x=0,03)=23,1$  меВ, а на залежності  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$  виникає

Зрозуміло, що подальше легування максимум. напівпровідника діркового типу провідності акцепторною домішкою буде лише зменшувати ступінь компенсації, а значення амплітуди модуляції зон неперервних енергій також будуть зменшуватися (рис.6б). Оскільки у напівпровіднику p-Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, де дірки є основними носіями струму, концентрація акцепторів наростає за лінійним законом, то логічно очікувати такого ж зменшення значень  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$ . Однак, зміна значень залежності  $\varepsilon_1^{a}(x)$  (рис. 66) для випадків x > 0,01 нагадує зміну значень  $\varepsilon_1^{\rho}(x)$  (рис. 6*a*), що також свідчить про одночасне генерування у кристалі акцепторів та донорів за невідомим механізмом.

Характер зміни значень енергії активації стрибкової провідності  $\varepsilon_3^{\rho}(x)$  та енергії активації  $\varepsilon_3^{a}(x)$  Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn (рис. 6) також вказують на генерування у кристалі дефектів донорної природи. Дійсно, монотонне збільшення числа дефектів акцепторної природи у напівпровіднику діркового типу провідності повинно привести до зменшення значень енергії активації стрибкової провідності  $\varepsilon_3^{\rho}(x)$  за таким же законом, оскільки зменшиться радіус локалізації електрона. Однак, як видно з рис. 6a, швидкість зменшення значень  $\varepsilon_3^{\rho}(x) \in$  різною на ділянках x = 0 - 0,03 та при x > 0,03. Така поведінка



**Fig. 6.** Change the values of activation energy  $\varepsilon_1^{\rho}(x)$  (1) i  $\varepsilon_3^{\rho}(x)$  (2) (*a*) Ta  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$  (1) i  $\varepsilon_3^{\alpha}(x)$  (2) (*b*) Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn.



**Fig. 7**. Calculated (1) and experimental (2) data of the depth of Fermi level  $\varepsilon_F(x)$  (a) and dynamic changes in the concentration of atoms Ni in position Hf (1) and vacancies in position Sn (2) (b) for the Hf<sub>1-X</sub>Tm<sub>X</sub>NiSn.

енергії активації  $\varepsilon_3^{\rho}(x)$  є можливою лише за умови появи донорів, які «тормозять» зменшення радіусу локалізації електрона та швидкість зменшення довжини стрибка [9]. Характер зміни значень амплітуди модуляції дрібномасштабної флуктуації  $\varepsilon_3^{a}(x)$  (рис. 66) подібний до такого для  $\varepsilon_3^{\rho}(x)$  (рис. 6*a*), що можливе лише за умови генерування у напівпровідниковому твердому розчині Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, поряд з акцепторами, донорів, що змінює ступінь компенсації.

Таким чином, результати кінетичних досліджень  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$  вказують на складний механізм одночасного генерування структурних дефектів акцепторної та донорної природи, які не були ідентифіковані структурними дослідженнями, оскільки їхня концентрація лежить за межами точності рентгенівських методів.

### V. Уточнення кристалічної та електронної структур Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn

Оскільки до кінця незрозумілий механізм генерування дефектів різної природи у реальному кристалі Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, вирішимо зворотню задачу. Відомо, що для розрахунку енергії електрона у

першій зоні Бріллюена необхідно знати просторове розташування атомів (або їхню відсутність вакансії) у вузлах елементарної комірки. З іншого боку, найменші зміни структури кристалу змінюють його локальну симетрію та густину електронних станів. У такому разі адекватність результатів розрахунку розподілу густини електронних станів DOS та результатів експериментальних досліджень за замовчуванням передбачає, що модель структури речовини у повній мірі відображає просторове розташування атомів у кристалі. А тому результати розрахунку електронної структури у співставленні з результатами дослідженьфізичних властивостей дають можливість отримати інформацію про реальну структуругкристалу, недоступну при використанні рентгенівських методів.

Використовуючи прив'язку до числових значень енергії активації  $\varepsilon_1^{\rho}(x)$  з рівня Фермі  $\varepsilon_F$  на край валентної зони Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn шукали ступінь компенсації (співвідношення структурних дефектів акцепторної та донорної природи), яка забезпечить експериментально встановлену швидкість руху рівня Фермі  $\varepsilon_F$ , показану на рис. 7*a*, крива 2.

Розрахунки DOS проведені для різних варіантів як розташування атомів у вузлах елементарної комірки, так і ступеню зайнятості усіх



**Fig. 8.** Calculation of the electron density of states DOS considering changes in the concentration of Ni atoms in position Hf, and vacancies in positions Sn for Hf<sub>1-X</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn.

кристалографічних позицій  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$  власними або чужими атомами. Виявилося, що найбільш прийнятним є варіант просторового розташування атомів в упорядкованій, однак сильно деформованій кристалічній структурі, в якій відбулися наступні зміни:

а) генерування у кристалографічній позиції 4*a* структурних дефектів акцепторної природи при заміщенні атомів Hf на атоми Tm, а формула має вигляд Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn;

б) упорядкування кристалічної структури приводить до зменшення числа структурних дефектів донорної природи (y), оскільки атоми Ni покидають позицію атомів Hf (4a), а формула твердого розчину набере вигляду (Hf<sub>1-y</sub>Ni<sub>y</sub>)<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn;.

в) поява та збільшення числа вакансій (z) у позиції атомів Sn (4b), а тому остаточний варіант формули твердого розчину має вигляд  $(Hf_{1-y}Ni_y)_{1-x}Tm_xNiSn_{1-z}$ .

Динаміка зміни концентрації вакансій у позиції 4b атомів Sn у  $(Hf_{1-y}Ni_y)_{1-x}Tm_xNiSn_{1-z}$  зображена на рис. 7б. Розрахована на цій основі динаміка руху рівня Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  у напрямі валентної зони показана на рис. 7а, крива 1, яка є близькою до такої, отриманої з високотемпературних ділянок залежностей  $\ln\rho(1/T)$ (рис. 3). З іншого боку, враховуючи значний атомний радіус атомів Sn ( $r_{\rm Sn} = 0,162$  нм), поява вакансій у позиції 4b атомів Sn приведе до суттєвої деформації кристалічної гратки  $(Hf_{1-v}Ni_v)_{1-x}Tm_xNiSn_{1-z}$  і, як наслідок, при певних концентраціях домішкових атомів Tm (x > 0,40) порушиться стабільність структури через її сильну деформацію, що пояснює обмежену розчинність Tm, отриману як експериментальними дослідженнями (рис. 1a), так і прогнозовану розрахунками зміни значень вільної енергії  $\Delta G$  Hf<sub>1-*x*</sub>Tm<sub>*x*</sub>NiSn (рис. 1*б*).

На основі отриманих знань про механізми генерування структурних дефектів у напівпровідниковому твердому розчині Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn, що визначають його електронну структуру, проведено розрахунок густини електронних станів DOS (рис. 8).

Показана на рис. 8 модель електронної структури  $Hf_{1-x}Tm_xNiSn$  адекватно відображає наявну у напівпровідниковому твердому розчині ступінь компенсації. Як можна бачити, рівень Фермі  $\varepsilon_F$  повільно дрейфує у напрямі валентної зони, що спричинено одночасним генеруванням у кристалі структурних дефектів акцепторної та донорної природи, причому, як видно з рис. 7*б*, швидкість генерування донорів (нахил кривої 2) наростає при збільшенні концентрації уведених атомів Tm.

На рис. 9 приведено, на нашу думку, найбільш переконливий результат, який підтверджує висновок про генерування у кристалі структурних дефектів донорної природи у результаті виникнення вакансій у позиції 4b атомів Sn. Було проведено розрахунок зміни значень густини станів на рівні Фермі  $g(\varepsilon_F)$ Нf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn як для упорядкованого варіанту структури, так і з урахуванням зміни концентрації атомів Ni у позиції 4a атомів Hf та вакансій у позиції 4b атомів Sn (рис. 9). Можемо бачити, що для упорядкованого варіанту структури (рис. 9, крива 1)



**Fig. 9.** Calculation of changes in the values of density of states at the Fermi level  $g(\epsilon_F)$  for  $Hf_{1-X}Tm_XNiSn$ : 1 - for ordered structure; 2 - taking into account changes in the concentration of atoms NI in position Hf, and vacancy in position Sn.

мінімум на залежності  $g(\varepsilon_{\rm F})$  пов'язаний з дрейфом рівня Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  від краю зони провідності до середини забороненої зони, яку перетне при  $x \approx 0,02$ , а за концентрацій  $x \ge 0,04$  рівень Фермі зайде у валентну зону.

Однак, якщо при розрахунку DOS врахувати зміни концентрації атомів Ni у позиції Нf та вакансій у позиції Sn, то зміна значень густини станів на рівні Фермі  $g(\varepsilon_{\rm F})$  практично абсолютно співпадає з результатами експериментальних досліджень. Дійсно, як можна бачити з рис. 9, крива 2, густина станів на рівні Фермі  $g(\varepsilon_{\rm F})$  незначно змінюється на ділянці концентрацій x = 0 - 0.07, поки рівень Фермі є<sub>F</sub> знаходиться у забороненій зоні. І лише при перетині рівнем Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  краю валентної зони за x =0,10 має місце збільшення значень  $g(\varepsilon_{\rm F})$ , що поняттями фізики узгоджується з основними напівпровідників.

Таким чином, у результаті комплексного дослідження структурних, енергетичних та характеристик напівпровідникового кінетичних твердого розчину Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn встановлено природу механізмів генерування структурних дефектів, що супроводжується зміною ступеню компенсації напівпровідника та ширини забороненої зони, суть яких в одночасному зменшенні та ліквідації структурних дефектів донорної природи у результаті витіснення ~1% атомів Ni з позиції Hf (4a), генерування структурних дефектів акцепторної природи при заміщенні атомів Hf у позиції 4a атомами Tm та генерування дефектів донорної природи у вигляді вакансій у позиції атомів Sn (4b).

Робота виконана у рамках грантів НАН і МОН України, № 0113U007687 і № 0114U005464.

*Ромака Л.П.*- к.х.н., доцент, провідний науковий співробітник;

*Крайовський В.Я.* - к.т.н., доцент, проректор Національного університету "Львівська політехніка"; *Ромака В.В.*- к.х.н., докторант;

*Рогль П.-Ф.* (*Rogl Peter-Franz*) - доктор фізики, професор Інституту фізичної хімії;

*Стадник Ю.В.* - к.х.н., провідний науковий співробітник;

*Горинь А.М.* - к.х.н., старший науковий співробітник.

Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур...

- [1] V.V. Romaka, L.P. Romaka, V.Ja. Krajovs'kij, Ju.V. Stadnik, Stanidi ridkisnozemel'nih ta perehidnih metaliv (L'vivs'ka politehnika, L'viv, 2015).
- [2] V.A. Romaka, V.V. Romaka, Ju.V. Stadnik, Intermetalichni napivprovidniki: vlastivosti ta zastosuvannja (L'vivs'ka politehnika, L'viv, 2011).
- [3] C. Uher, J. Yang, S. Hu, D.T. Morelli, G.P. Meisner, Phys. Rev. B 59(13), 8615 (1999).
- [4] S.R. Culp, S.J. Poon, N. Hickman, T.M. Tritt, J. Blumm, Appl. Phys. Letters 88(16), 042106 (2006).
- [5] G.S. Nolas, J. Poon, M. Kanatzidis, MRS Bulletin 31(3), 199 (2006).
- [6] V.V. Romaka, P. Rogl, L. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Grytsiv, O. Lakh, V. Krayovsky, Intermetallics 35, 45 (2013).
- [7] V.A. Romaka, P. Rogl, V.V. Romaka, D. Kaczorowski, Yu.V. Stadnyk, R.O. Korh, V.Yu Krajovskii. and T.M. Kovbasyuk, Semiconductors 49(3), 290 (2014).
- [8] Termoelektrika (u druci)
- [9] B.I. Shklovskij, A.L. Jefros, Jelektronnye svojstva legirovannyh poluprovodnikov (Nauka, Moskva, 1979).
- [10] T. Roisnel, J. Rodriguez-Carvajal, Mater. Sci. Forum, Proc. EPDIC7, 378-381, 118 (2001).
- [11] M. Schruter, H. Ebert, H. Akai, P. Entel, E. Hoffmann, G. Reddy, Phys. Rev. 52, 188 (1995).
- [12] V.L. Moruzzi, J.F. Janak, A.R. Williams, Calculated electronic properties of metals (Pergamon Press, NY, 1978).
- [13] V.A. Romaka, D. Fruchart, E.K. Hlil, R.E. Gladyshevskii, D. Gignoux, V.V. Romaka, B.S. Kuzhel, and R.V. Krayjvskii, Semiconductors 44(3), 293 (2010).
- [14] V.A. Romaka, Yu.V. Stadnyk, V.V. Romaka, D. Fruchart, Yu.K. Gorelenko, V.F. Chekurin and A.M. Horyn, Semiconductors 41(9), 1041 (2007).

L.P. Romaka<sup>1</sup>, V.V. Romaka<sup>2</sup>, V.Ya. Krayovskyy<sup>2</sup>, Yu.V. Stadnyk<sup>1</sup>, P.-F. Rogl<sup>3</sup>, A.M. Horyn<sup>1</sup>

### Investigation of Crystal and Electronic Structures Features of Hf<sub>1-x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn Semiconductor Solid Solution

<sup>1</sup>Ivan Franko National University of Lviv, 6, Kyryla and Mefodiya Str., Lviv, 79005, Ukraine,

e-mail: <u>romakal@franko.lviv.ua;</u>

<sup>2</sup>National University "Lvivska Politechnika", 12, S. Bandera Str., Lviv, 79013, Ukraine; <sup>3</sup>Universität Wien, 42, Währinger Str., Wien, A-1090, Österreich;

The features of structural, energy state and electrokinetic characteristics were investigated for  $Hf_{1,x}Tm_xNiSn$  solid solution in the range: T = 80 - 400 K, x = 0 - 0.40. It was confirmed partly disorder crystal structure of HfNiSn compound as a result of occupation in the 4*a* crystallographic site of Hf  $(5d^26s^2)$  atoms by Ni  $(3d^84s^2)$  ones up to ~ 1 % that generates in the crystal structural defects of donor nature. It was shown that introduction of Tm atoms ordered crystal structure ("healing" of structural defects). It was established mechanisms of simultaneous generation of structural defects as acceptors by substitution of Hf  $(5d^26s^2)$  by Tm  $(4f^{43}5d^06s^2)$  atoms, and the donor nature defects as a result of the appearance of vacancies in the Sn (4b) atoms sites, which determines the mechanisms of conductivity for Hf<sub>1,x</sub>Tm<sub>x</sub>NiSn.

Keywords: crystal and electronic structures, conductivity, thermopower coefficient.